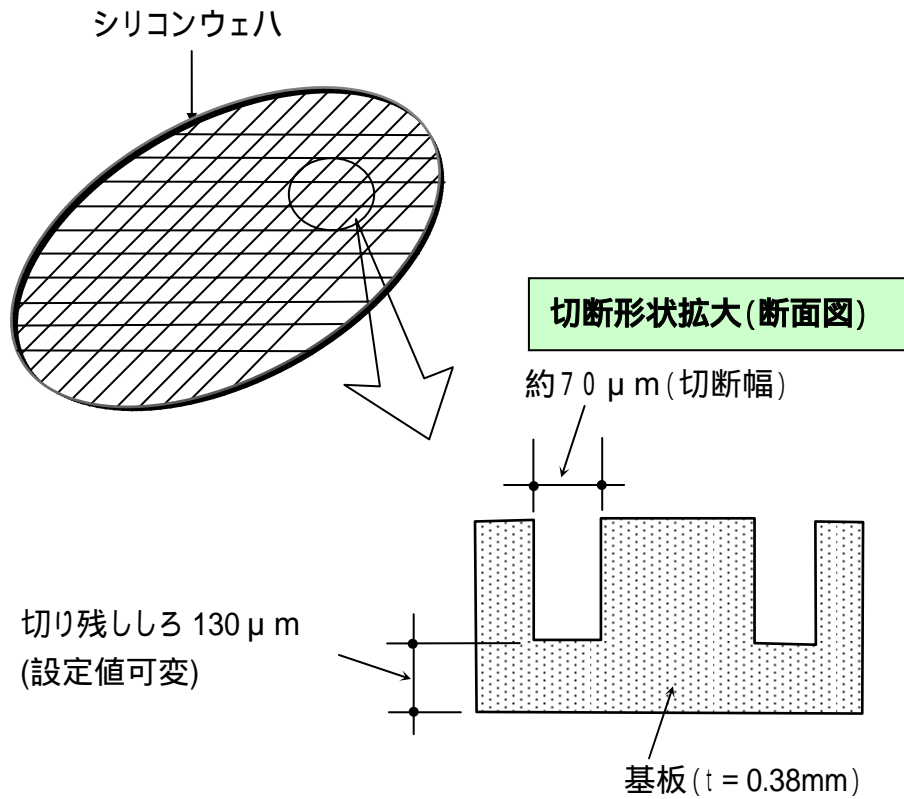


11. ダイシング加工(各種基板の格子状切断)

(1)シリコンウェハを短冊状に切断した(1×7 mm)

(ホイールカット:ホイールの材質選定により、各種材質基板の切断可能)



(2)要素技術と加工内容等

要素技術	加工内容等
ダイシング	・ダイシングマシンによる短冊状カット (各種基板対応)
スクライピング	・ダイヤモンドポイントを使用した スクライプカット (ガラス切りと同等・基板制約あり)